УДК 621.315.592

## МЕХАНИЗМ ТОКОПЕРЕНОСА В ГЕТЕРОПЕРЕХОДЕ p-InSb-n-CdTe

# С.Г. ПЕТРОСЯН<sup>1,2</sup>, Л.А. МАТЕВОСЯН<sup>1,2</sup>, К.Э. АВДЖЯН<sup>1,2\*</sup>, С.Р. НЕРСЕСЯН<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Российско–Армянский университет, Ереван, Армения <sup>2</sup>Институт радиофизики и электроники НАН Армении, Аштарак, Армения

\*e-mail: avjyan@gmail.com

(Поступила в редакцию 30 ноября 2018 г.)

На основе анализа прямой ветви вольт-амперной характеристики экспериментально подтверждено наличие двух механизмов переноса заряда через гетеропереход p-InSb-n-CdTe, полученного методом лазерно-импульсного осаждения. При относительно небольших напряжениях внешнего смещения (0.03 В < U < 0.15 В) ток удовлетворительно согласуется с выражением  $I \sim \exp(qU/\eta kT)$  с коэффициентом идеальности  $\eta = 1$ . Выше 0.18 В вольт-амперная характеристика подчиняется закону  $I \sim U^{3/2}$  с последующим выходом на линейный участок (напряжение отсечки – 0.47 В). Дана теоретическая модель токопрохождения с учетом особенностей разрыва зон в гетеропереходе, приводящей к возникновению инверсионного слоя вблизи границы раздела.

#### 1. Введение

Создание устройств генерации и приема электромагнитного излучения инфракрасного (ИК) диапазона продиктовано широким использованием приемных и передающих устройств этого диапазона для решения важных задач, как мониторинг атмосферы, диагностика повреждений газо- и нефтепроводов, тепловидение с повышенным температурным контрастом, беспроводная оптическая связь, обнаружение тепловых объектов и другие.

Ранее нами с помощью простой низкотемпературной технологии лазерноимпульсного осаждения (исключая процессы имплантации, высокотемпературной диффузии и отжиг) были изготовлены p-InSb–n-CdTe гетеропереходные (ГП) фотоприемники, чувствительные в диапазоне 1–5.8 мкм оптического спектра [1– 3]. В частности, показано, что такие одиночные фотоприемники могут иметь интегральную чувствительность не ниже 1000 мВ/мВт, время фотоотклика порядка 15 нс, обнаружительная способность порядка 1.8×10<sup>11</sup> см Гц<sup>1/2</sup> Вт<sup>-1</sup> на длине волны 4.8 мкм. По этим параметрам они не уступают традиционным фотоприемникам на основе InSb [4]. Нами также показано, что при определенной конфигурации фоточувствительной поверхности фотоприемника и расположении контактов появляется возможность определения пространственного положения и параметров движения различных объектов, излучающих в ИК диапазоне [5]. Отметим, что примененная нами технология существенно отличается от ранее представленных технологий, где рост кристаллической пленки CdTe на подложке из InSb приводит к образованию некогерентного интерфейса, который затрудняет изготовление качественного гетероперехода. Образованные на границе раздела соединения были идентифицированы как In<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> [6] или напряженная фаза InTe [7]. Однако механизм переноса заряда (МПЗ) в полученном нами ГП p-InSb–n-CdTe до сих пор не был подробно изучен.

Данная работа посвящена исследованию МПЗ в ГП p-InSb-n-CdTe на основе изучения вольт-амперной характеристики структуры при азотной температуре с учетом особенностей разрыва и изгиба зон в ГП, приводящих к возникновению инверсионного слоя вблизи границы раздела.

### 2. Эксперимент и результаты измерений

Для изготовления ГП p-InSb-n-CdTe нами был использован метод лазерно-импульсного осаждения (ЛИО), который обеспечивает эпитаксиальный рост пленок CdTe на пластинах InSb при довольно низких температурах подложки ( $T_{\rm n} = 240 - 250^{\circ} {\rm C}$ ), благодаря чему практически исключается взаимная диффузия компонент полупроводников. Пленки CdTe толщиной 500 нм осаждены на полированную подложку из p-InSb (толщина – 500 мкм; концентрация акцепторов –  $N_{\rm A} = 4.17 \times 10^{14}$  см<sup>-3</sup>). Из-за близости постоянных решеток (рассогласование меньше 0.03 %) и коэффициентов термического расширения следует ожидать, что выращенный гетеропереход будет близок к идеальному. Измерением толщины на профилометре Mitutoyo Surftest SJ-410 и исследованием кристаллической структуры пленки методом дифракции электронов на электронографе ЭМР-100М установлены оптимальные технологические режимы получения кристаллических пленок (интенсивность испаряющего лазерного излучения на мишени из CdTe была  $2 \times 10^8$  Bt/cm<sup>2</sup>, толщина осажденного слоя за один испаряющий импульс – 2.7 нм, преимущественная ориентация пленки CdTe-(110), при которых толщина пленки CdTe на краях отличается от среднего участка на 10 % (площадь  $-0.8 \times 0.8$  см<sup>2</sup>). Морфология слоев CdTe изучена на сканирующем электронном микроскопе (SEM) VEGA TS 5130MM, что подтверждает плотноупакованность пленки и ее безпористость. Далее на пленке СdTe термическим осаждением индия получен металлический контакт (диаметр контакта около



Рис.1. ВАХ ГП p-InSb-n-CdTe.

0.3 мм). Тыльная сторона подложки термическим осаждением была целиком покрыта также индием, который образует хороший омический контакт. На приборе KEITHLEY-6430 при температуре 78 К исследована темновая вольт-амперная характеристика (BAX) ГП p-InSb–n-CdTe, показанная на рис.1.



Рис.2. Прямая ветвь ВАХ ГП p-InSb-n-CdTe..

Для удобства анализа МПЗ через ГП и с целью установления доминирующих механизмов, прямые ветви ВАХ были построены в полулогарифмическом (рис.2а) и двойном логарифмическом масштабах (рис.2b).

Из приведенных графиков следует наличие двух доминирующих МПЗ через ГП. При относительно небольших напряжениях смещения (0.03 B < U < 0.15 B) ток удовлетворительно согласуется с выражением  $I \sim \exp(eU/\eta kT)$ , где коэффициент идеальности  $\eta = 1$  (рис.2а). В области напряжений 0.18 B < U < 0.42 B ВАХ подчиняется закону  $I \sim U^{3/2}$ . При U > 0.45 B прямой ток линейно зависит от напряжения по закону  $I = (U - U_0)/R_0$ , где  $U_0 = 0.47$  В – токовое напряжение отсечки, а  $R_0 = 23$  Ом – остаточное дифференциальное сопротивление перехода.

В следующем разделе представлена объясняющая ВАХ модель токопрохождения, основанная на приведенной в предыдущей нашей работе [3] зонной диаграмме идеального ГП p-InSb–n-CdTe (рис.3).



Рис.3. Зонная диаграмма ГП p-InSb-n-CdTe.

#### 3. Модель токопрохождения

При образовании ГП p-InSb – n-CdTe из-за большой контактной разности потенциалов и разрыва зон в узкозонном полупроводнике вблизи границы раздела формируется слой с инверсной проводимостью (рис.3), т.е. в p-InSb, где кроме слоя полного обеднения (шириной  $w_p$ ) с поверхностной плотностью отрицательного объемного заряда акцепторов  $Q_A$  существует также заряд свободных электронов Q<sub>n</sub>, локализованных на некотором среднем расстоянии от границы раздела. Этот суммарный отрицательный заряд компенсируется положительным зарядом доноров  $Q_D$  в слое полного обеднения в n-CdTe, имеющем ширину  $w_n$ . Поскольку в валентной зоне существует разрыв зон более 1 эВ, то составляющей тока перехода, обусловленной инжекцией дырок в n-CdTe, можно пренебречь. Ток перехода при прямом смещении будет обусловлен инжекцией электронов в квазинейтральную область InSb и их последующей диффузией и рекомбинацией с дырками. Здесь, однако, надо иметь в виду, что в общем случае электроны могут инжектироваться из двух «резервуаров»: из широкозонной области n-CdTe и из ямы инверсионного слоя. В общем случае вклады этих резервуаров в ток перехода разные, так как они отличаются друг от друга не только концентрацией электронов, но высотой барьера, преодолевая которые электроны могут инжектироваться в квазинейтральную часть InSb. Как следует из рис.3, в равновесии

высота барьера для надбарьерной инжекции электронов из n-CdTe составляет около 0.2 эВ, в то время как для электронов, локализованных в яме инверсионного слоя, глубина ямы больше и составляет 0.25 эВ. При малых прямых смещениях в формировании тока перехода, во-первых, будут давать электроны, инжектированные из n-CdTe, значительная доля которых, без термализации и захвата в яму, может достичь края области пространственного заряда (ОПЗ) в р-InSb и, увеличивая концентрацию неосновных носителей, создаст часть диффузионного тока перехода. Во-вторых, из-за уменьшения глубины инверсионной ямы из нее тоже может начинаться дополнительная инжекция электронов в квазинейтральную область p-InSb, дающая некоторый вклад в рост общего тока ГП. Здесь необходимо, однако, заметить, что в отличие от квазинейтральной области n-CdTe, концентрация электронов в инверсионном слое не постоянна, зависит от изгиба зон в p-InSb и уменьшается с ростом прямого смещения. В добавок к этому, если учесть, что заряд электронов, сосредоточенных в инверсионном слое, в свою очередь влияет и на распределение внешнего смещения между компонентами ГП, то становится понятным, что формирование вольт-амперной характеристики такого гетероперехода является сложным процессом. Ее конкретный вид зависит от многих факторов, связанных как друг с другом, так и от величины внешнего смещения. В эксперименте наблюдается рост тока как  $I \sim U^{\alpha}$  ( $\alpha \approx 3/2$ ). Мы покажем, что в нашей модели, в некотором интервале прямых напряжений, рост тока действительно может описываться такой степенной зависимостью.

Контактную разность потенциалов  $\Delta \varphi_K$  в равновесии можно представить в виде суммы диффузионных потенциалов, приходящихся в n- и p-областях:  $\Delta \varphi_K = \varphi_{n0} + \varphi_{p0}$ . При наличии внешнего смещения U часть его (U<sub>1</sub>) падает в ОПЗ CdTe, часть (U<sub>2</sub>) – в ОПЗ InSb. Соответственно и уменьшаются высота потенциального барьера для электронов как из CdTe, так и глубина потенциальной ямы в ОПЗ p-InSb. Они становятся равными ( $\varphi_{n0} - U_1$ ) и ( $\varphi_{p0} - U_2$ ). Для нахождения зависимостей зарядов ионизованных доноров  $Q_D$ , акцепторов  $Q_A$  в ОПЗ, а также электронов в инверсионном слое  $Q_n$ , в условиях сильной инверсии, необходимо решить уравнение Пуассона с учетом вклада всех этих зарядов [8]. Тогда уравнение электронейтральности для перехода  $Q_n + Q_A = Q_D$  можно представить в виде:

$$\sqrt{\frac{\varepsilon_0\varepsilon_2kTN_A}{2}}\exp\left[\frac{q(\phi_{p0}-2\phi_0-U_2)}{kT}\right] + \sqrt{2q\varepsilon_0\varepsilon_2N_A(2\phi_0-\frac{kT}{q})}$$

$$= \sqrt{2\varepsilon_0\varepsilon_1N_Dq(\Delta\phi_k-\phi_{p0}-U_1)}$$
(1)

где  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$  – диэлектрические проницаемости полупроводников CdTe и InSb,  $\varepsilon_0$  – электрическая постоянная, q – элементарный заряд,  $q\phi_0$  – есть энергетическое расстояние между серединой запрещенной зоны и уровнем Ферми в объеме p-InSb. Это уравнение позволяет найти распределение внешнего напряжения между OII3 CdTe и InSb. Здесь мы учли тот факт, что при наличии электронного

инверсионного слоя величина заряда ионизованных акцепторов (второй член в правой части (1)) не зависит от потенциала границы раздела и задается изгибом зон в момент начала сильной инверсии.

С учетом вкладов в ток электронов, инжектированных как из n-CdTe, так и из инверсионной ямы, плотность тока перехода можно представить в виде:

\_

$$j = \frac{qD_n}{L_n} \left[ \gamma N_D \exp\left(-\frac{q(\Delta \phi_k - \phi_{po})}{kT}\right) \left( \exp\left(\frac{qU_1}{kT}\right) - 1 \right) + n(0) \exp\left(-\frac{q\phi_{po}}{kT}\right) \left( \exp\left(\frac{qU_2}{kT}\right) - 1 \right) \right] \equiv$$

$$\equiv j_0 \left[ \gamma \exp\left(-\frac{q(\Delta \phi_k - \phi_{po} - 2\phi_0)}{kT}\right) \left( \exp\left(\frac{qU_1}{kT}\right) - 1 \right) + \xi \left( \exp\left(\frac{qU_2}{kT}\right) - 1 \right) \right],$$
(2)

где  $\gamma$  – есть доля нетермализованных в яме электронов,  $D_n$ ,  $L_n$  – коэффициент и

Параметр	p-InSb	n-CdTe
Ширина запрещенной зоны <i>Eg</i> (77К), эВ	0.234	1.6
Концентрация доноров N <sub>D</sub> , см <sup>-3</sup>	_	1.13×10 <sup>15</sup>
Концентрация акцепторов N <sub>A</sub> , см <sup>-3</sup>	4×10 <sup>14</sup>	_
Диэлектрическая проницаемость Е	16.8	7.1
Эффективная плотность состояний в зоне проводимости $N_C$ (77K), см <sup>-3</sup>	_	10 <sup>17</sup>
Эффективная плотность состояний в валентной зоне N <sub>V</sub> (77K), см <sup>-3</sup>	9.45×10 <sup>17</sup>	_
Положение уровня ферми в n-CdTe, эВ	-	0.02
Положение уровня ферми в p-InSb, эВ	0.05	_
Электронное сродство ҳ, эВ	4.59	4.3
Разрыв зон в зоне проводимости $\Delta E_C$ , эВ	0.29	_
Диффузионная длина электронов L <sub>n</sub> , мкм	4.47	_
Коэффициент диффузии электронов <i>D</i> <sub>n</sub> , см <sup>2</sup> /с	2×10 <sup>3</sup>	_
Время жизни неосновных носителей т <sub>n</sub> , с	10 <sup>-10</sup>	_

Параметры	, используемые при расчете ВАХ ГП
-----------	-----------------------------------

длина диффузии электронов в p-InSb, а n(0) – есть объемная концентрация электронов в инверсионной яме, которая задается величиной изгиба зон и средней длиной локализации электронов от границы раздела  $\lambda_c$  [8]

$$n(0) = \frac{\sqrt{2kT}\,\varepsilon_2\varepsilon_0 N_A}{q\lambda_c} \exp\left(\frac{q(\phi_{p0} - 2\phi_0)}{kT}\right). \tag{3}$$

При численном расчете ВАХ нами были использованы параметры ГП, представленные в таблице. Используя их и выбрав  $\gamma = 0.75$  и  $\lambda_c = 100$ Å, получаем  $\xi = 0.28$ .

Расчеты показывают, что при относительно небольших внешних смещениях, когда сохраняются значительные изгибы зон, а в потенциальной яме продолжает иметь место режим сильной инверсии, распределение внешнего напряжения между компонентами ГП осуществляется в пропорции  $U_1/U_2 \sim 10$ . С ростом напряжения это соотношение уменьшается, но, по-прежнему, большая часть внешнего смещения продолжает падать на область объемного заряда п-CdTe. Ho, с другой стороны, поскольку концентрация электронов в инверсионной яме зависит экспоненциально от изгиба зон, величина которого при прямом смещении уменьшается на величину  $U_2$ , то точную оценку относительного вклада в общий ток перехода электронов, инжектированных из CdTe и из инверсионной ямы, описываемых первым и вторым членами в выражении (2), можно получить лишь с помощью согласованного численного расчета.

На рис.4 представлена рассчитанная с помощью полученных выше формул зависимость прямого тока ГП от напряжения (безразмерные единицы) в двойном логарифмическом масштабе в интересующем нас интервале внешних смещений. Видно, что вольт-амперную характеристику ГП действительно можно описать зависимостью типа  $j \sim U^{\alpha}$ , где  $\alpha \approx 1.5$ .



Рис.4. Теоретическая ВАХ ГП в двойном логарифмическом масштабе. Здесь напряжение и плотность тока представлены в относительных величинах ( $U_0' = 0.18$  B,  $J_0' = 3.6$  мА/см<sup>2</sup>).

#### 4. Заключение

Таким образом, в работе показано, что такая особенность зонной структуры ГП p-InSb-n-CdTe как наличие вблизи границы раздела инверсионного слоя в p-InSb существенно может видоизменять прямую ветвь его BAX. В частности, аналогично токам, ограниченным объемным зарядом, в некотором интервале прямого смещения может наблюдаться степенная зависимость тока от напряжения. Наличие инверсионного слоя следует иметь в виду и при исследовании вольт-фарадных и фотоэлектрических характеристик ГП p-InSb-n-CdTe.

Работа выполнена в совместной лаборатории Института радиофизики и электроники НАН РА и Российско-Армянского университета при финансовой поддержке в рамках субсидии МОН РФ.

#### ЛИТЕРАТУРА

- A.G. Alexanian, Al.G. Alexanian, R.K. Kazarian, L.A. Matevosian, H.S. Nickogosian. Int. J. of Infrared and Millimeter Waves, 14, 2203 (1993).
- A.G. Alexanian, N.S. Aramyan, K.E. Avjyan, A.M. Khachatryan, R.P. Grigoryan, A.S. Yeremyan. Combinatorial and High-Throughput Discovery and Optimization of Catalysts and Materials, R.A. Potirailo, W.F. Maier (eds.), CRC/Taylor & Francis, 2006.
- 3. Л.А. Матевосян, К.Э. Авджян, С.Г. Петросян, А.В. Маргарян. Успехи прикладной физики, 2, 403 (2014).
- 4. Hamamatsu technical information, available https://www.hamamatsu.com/us/en/product/index.html
- 5. А.В. Маргарян, С.Г. Петросян, Л.А. Матевосян, К.Е. Авджян. Изв. НАН Армении, Физика, 51, 272 (2016).
- 6. D.R.T. Zahn et al. Appl. Surf. Sci. 41/42, 497 (1989).
- 7. R.G. van Welzenis et al. Appl. Phys. A52, 19 (1991).
- 8. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов, т.1, М., Мир, 1984, 456 стр.

## CURRENT TRANSPORT MECHANISM IN p-InSb-n-CdTe HETEROJUNCTION

#### S.G. PETROSYAN, L.M. MATEVOSYAN, K.E. AVJYAN, S.R. NERSESYAN

Based on the analysis of the forward current-voltage characteristics of the p-InSb– n-CdTe heterojunction, fabricated by a method of pulsed laser deposition, the existence of two charge injection mechanisms was experimentally confirmed. At relatively small external bias voltages (0.03 V < U < 0.15 V), the current is in satisfactory agreement with the expression  $I \sim \exp(qU/\eta kT)$  with ideality factor  $\eta = 1$ . Above 0.18 V, the current-voltage characteristic obeys the law  $I \sim U^{3/2}$  with a subsequent exit to the linear part (current cut-off voltage – 0.47 V). A theoretical model of current transport is given taking into account the peculiarities of the heterojunction band bending, leading to the appearance of inversion layer near the interface.